公開実用 昭和63 168931

⑩ 日本 国特 許 庁(JP) ⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 昭63-168931

		713 7 4 -	砂公開 昭和63年(1988)11月2日	
©Int_Cl_4 H 01 H 13/02 9/16 13/52 H 01 L 33/00 H 05 K 1/18	識別記号	庁内整理番号 A-8224-5G A-7161-5G E-8729-5G H-7733-5F N-6736-5F	每公開 昭和65年(1	- T)

図考案の名称 チップLEDの取付構造

②実 頭 昭62-61469

參出 闡 昭62(1987)4月24日

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社 敛考案者 淹沢 正良

でい出 関 人 アルブス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

愈代 理 人 弁理士 武 顯次郎



慧 組 叨

- 1. 考塞の名称
 - チップLEDの取付構造
- 2. 実用新室登録請求の範囲

チツプLEDの外殻を形成する透明樹脂製の筐 体から端子が突設され、該端子をプリント基板の 導体パターンに接続するチップLEDの取付構造 において、前記プリント基板に取付孔を穿設する とともに、前記筐体にテーパ面を形成し、該テー パ面を削記取付孔に圧入した状態で削記端子を前 記プリント基板の導体バターンに導電材料を介し て接続したことを特徴とするチツプLEDの取付 構造。

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案はチツプレEDの取付構造、特にプリン ト悲极に対するチツブLEDの取付構造に関する ものである。

(従来の技術)

第2図はプリント基板に対するチップLEDの

1

400

公局実用 昭和63-168931

従来の取付構造を示す断面図で、図ではメンプレンスイツチのON-OFF動作表示のために、チップLEDがプリント基板に取り付けられた場合が示されている。

第2図において、1はプリント基板であり、こ のプリント基板1にはスペーサ2を介して、ポリ エチレンテレフタレートなどの可撓性を有するフ イルム3が積層されている。そして前記スペーサ 2には、操作用の透孔 4 a と収納用の透孔 4 b と が形成されている。また、前述の透孔 4 a 内の互 いに対向する位置において、前記フィルム3の下 面には上部電極5が、プリント基板1の上面には 下部電極 6 が印刷の手段で形成されている。從つ て、上部電極5位置において、前記フィルム3を 所定ストローク押し込むと、その上部電極5が対 向する下部電極6と接触してスイツチのON動作 が行なわれ、上部電極 5 に対する押圧力を解除す ると、フィルム3の可提性で上部電極5は下部電 極もから離反してスイツチのOFF動作が行なわ れる。さらに第2図において、符号7で総括的に 示すのはチツプLEDであり、このチツプLED 7は半導体チツプ8が透明樹脂材の策体9内にモ ールドされ、半導体チツプ8の端子10が篦体9 から突出形成されたものである。前述のチップL ED7は、透孔4b内において端子10がそれぞ れプリント基板1の所定の導体パターン11にク リームはんだの如き導電材料12を介して接続さ れて、プリント基板1に対して面実装されている。

上記チツプLED7は、小型であると言つても 通常この種の電子部品に用いられるスペーサ2の 厚み以上の高さを有しており、そのため前記フィルム3の透孔4bと対面する部分には突部13が エンボス加工されている。そして、例えば前ばしたスイッチのON動作によりチップLED7の点域はフィルム3の突部13を介して外部より視認される。

「考案が解決しようとする問題点」 - 前述せるように、従来のチップLEDの取付構

公開実用 昭和63-168931

造においては、チップLEDが取り付けられるプリント基板位置に対向する位置において、フィルムにエンボス加工を施すことが必要である。しかしながら、このエンボス加工自体は複雑な加工であるために、前述せる従来のチップLEDの取付もっために、前述せる従来のチップLEDの取付を表では工数が増加し、それに伴つて製造費用も増大していた。また一方では、フィルムの表面が平坦に仕上げられないために、他の構成部分、例えば表示シートとの組合せ構成が簡単に行なわれないという難点がある。

さらに、スイツチなどの操作部分に接近して配 される場合には、エンボス加工された突部の存在 が操作性を掛なうおそれもあり、基本的には全体 の薄型化と窓匠性の面でも難点がある。

本考案は、前述せるようなチップLEDの取付 構造の現状に鑑みてなされたものであり、その目 的とするところは、自動機を用いてチップLED を実装することができるとともに、全体の簡型化 が実現され、意匠性にも優れたチップLEDの取 付構造を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

前述せる目的を達成するために、本考案では、 チップLEDの外殻を形成する透明樹脂製の筐体 から端子が突設され、該端子をプリント基板の導 体パターンに接続するチップLEDの取付構造に おいて、前記筐体にチーパ面を形成し、該テーパ 直を前記取付孔に圧入した状態で前記端子が前記 プリント基板の導体パターンに導電材料を介して 接続された構成となつている。

(作用)

本考案ではチップLEDの笹体に形成されるテーパ面が、プリント基板に穿設される取付孔に圧入されているので、この圧入によりプリント基板に対してチップLEDを仮止めした後、チップLEDの端子とプリント基板の所定の専体パターン間にクリームはんだ等の選電材料を塗布して、チップLEDを効率的に実装することが出来る。

また、プリント基板の取付孔に対してチツプレ EDのテーパ面の圧入するため、特にシール加工

公開実用 昭和63-168931

を施さなくとも取付孔を密封することができ、気 密性の高い照光式スイツチを実現できる。

(実施例)

以下、本考案の実施例を第1図を用いて詳細に 説明する。

ここで、第1図は本考案の実施例の構成を示す 断面図であり、第2図と同一部分には同一符号が 付されている。

従つて、本考案の実施例においては、例えばパキュームによりチップLED7を保持して、該チップLED7の筺体9に形成されたテーパ面15を、プリント基板1の裏面側より取付孔14に嵌入させた状態で、チップLED7の端子10を自動はんだによりはんだ付けすることが出来る。

即ち、この場合には、プリント基板1に形成された取付孔14に、チップLED?をテーパ面15を嵌入させた状態で保持し、チップLED?の端子10とプリント基板1の所定の導体パターン11間にクリームはんだ12を塗布し、そのままリフロー炉に送り込んで端子10と所定の導体パターン11間をはんだ付けすることが出来る。

また、前述せるようにプリント基板1の取付孔 14に対して、チツプLED7のテーパ面15を 嵌入させて取り付けた状態において、チツプLE D7とプリント基板1間は充分な密封状態となつ ているため、かかるチツプLED7をスイツチと 組合わせて使用した場合は、気密性の高い照光式 スイツチが実現される。

公月実用 昭和63 168931

このように、本考案の実施例によるとチップし ED7を、プリント基板1に形成した取付孔14 内に長手方向の大部分を位置させて取り付けることが出来る。そのために、チップLED7をことの上面がプリント基板1の表面から突出させるとなることができ、よつて従来のように透孔4b位とすることが出来る。

さらに、製造工程中において、チツプLED7 をプリント基板1に仮止めすることができるため、 その後に行われる端子10のはんだ付けをリフローはんだ等の自動はんだを導入することが可能と なつて、製造工数及び製造費用を低減させること が出来る。

なお、上記した実施例は、メンプレンスイツチのON-OFF動作表示のために、チップLEDフがプリント基板1に取り付けられた場合を示すが、その表示動作はすでに第2図を用いて説明し

た場合と同様なので、その重複説明は省略する。 (考案の効果)

以上詳細に説明したように、本考案によると、 プリント基板の取付孔にチップLEDの筐体が挿入・保持されるようになつているため、自動実装が可能で、全体の薄形化が図れ、意匠性にも優れたチップLEDの取付構造を提供することが可能となる。

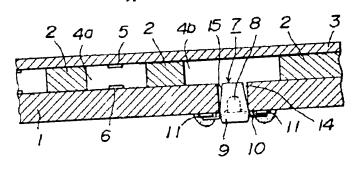
4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係るチップLEDの取付構造を示す断面図、第2図は従来例に係るチップLEDの取付構造を示す断面図である。

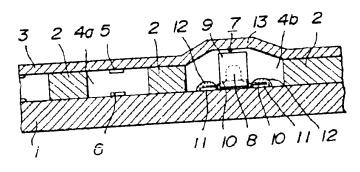
1 …… プリント基板、2 …… スペーサ、3 、 …… 可提性フィルム、4 a 、4 b … … 透孔、5 …… 上部電極、6 …… 下部電極、7 …… チップLED、8 …… 半導体チップ、9 …… … 筺体、10 …… 端子、11 …… 導体パターン、12 …… のリームはんだ(導電材料)、14 … … 取付孔、15 …… テーパ面。

△開実用 昭和63 168931

第 / 図



第 2 図



409 実開 GB - 1 68**9 3 1**